

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

## 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>券商策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	开源证券 罗通、刘天文； 中银三星人寿保险有限公司 石晴川； 光大永明资产管理股份有限公司 沈繁呈； 兴合基金管理有限公司 侯吉冉； 大家资产管理有限责任公司 徐博； 长城财富保险资产管理股份有限公司 胡纪元。
时间	2024年5月10日（星期五）
地点	北京金融街威斯汀酒店
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，公司拥有宁夏中晶、西安中晶、中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司。</p> <p>公司拥有先进的具备自主知识产权的核心技术和工艺，配</p>

备优良的生产、检测设备和管理系统，以国际一流半导体企业为标准，致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导体硅材料制造商而努力奋斗。

## 二、互动交流

### 1、请公司简要介绍，当前主营业务情况。

您好！公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于增产上量和新客户认证过程中；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型。

公司主要产品涵盖单晶硅棒、研磨硅片、化腐硅片、抛光硅片、半导体功率芯片及器件等，贯通了从晶棒端到器件芯片端的全链条生产制造环节，形成了独具特色的产业链一体化优势。上游产品为下游产品的生产提供了及时、稳定的原料保障，下游业务的发展，进一步丰富公司产品类型，促进公司实现产业上下游资源的整合，提升公司生产规模效应，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。谢谢。

### 2、请问贵公司募投项目产品订单量如何？

您好！以中晶新材料为实施主体的募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利，当前处于增产上量和新客户认证过程中。公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进募投项目的产能释放。谢谢。

**3、请问贵公司股份回购进展情况如何？有无进一步提高收购规模的计划？**

您好！公司股份回购计划在持续实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间，于每个月的前3个交易日内披露回购进展情况。截至2024年4月30日，公司累计回购230,000股，成交总金额为4,989,205.00元（不含交易费用）。后续如有新的回购计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。谢谢。

**4、请问江苏皋鑫项目产品规划如何？主要对标下游哪些客户群体？**

您好！江苏皋鑫现有厂房生产经营工作正常进行中。2023年8月，江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》正式开工，当前处于项目建设阶段。随着芯片项目推进，未来公司将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型。江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力，主营产品为半导体功率芯片及器件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。谢谢。

**5、公司 2023 年年度报告已披露，请问影响公司 2023 年业绩变动的主要原因是什么？**

您好！公司 2023 年业绩的主要影响原因是：（1）募投项目正处于爬坡上量阶段，产品成本较高，各项经营费用增加。（2）公司基于谨慎性原则对存货等资产进行减值测试，导致资产减值损失增加。（3）公司受下游客户需求下降影响，产能利用率不足，产品整体毛利率同比有所下降。谢谢。

**6、公司 2024 年一季度业绩扭亏的主要驱动因素有哪些？**

您好！公司一季度业绩同比上升的原因主要是：（1）公司重视各业务拓展工作，满足客户需求，进一步提升市场竞争优势。（2）公司重视产品质量，保障产品品质。（3）公司持续加大研发投入，优化生产工艺、开发新产品。未来，公司将努力做好生产经营工作，提升公司内在价值，以稳健的经营业绩与切实的社会责任担当回报投资者。谢谢。

**7、公司核心竞争力有哪些？**

您好！公司是一家专业从事半导体硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司的核心竞争力主要体现在：（1）持续的技术创新。公司始终专注于半导体硅材料行业研究，坚定实施创新驱动发展战略，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进技术研发项目，拥有多项生产制造核心技术。（2）科学的人才管理。公司坚持以人为本，尊重人才价值，高度关注和重视人才的引进与培养，提高公司创新实力。公司拥有一支爱岗敬业、开拓进取、业务扎实的专业人才团队，深耕半导体硅材料行业多年，具备专业的行业知识与管理经验、具有良好的职业素养，对本行业有深刻的认知。（3）严格的品质管控。公司始终坚持产品质量标准，持续优化生产操作流程，严格把关产品生产的各个环节，建立有完善

	<p>的生产质量管理体系，公司及子公司已经 IATF16949:2016、IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018 认证体系认证，贯标各项管理体系，保障产品质量。（4）不断的市场开拓。公司深耕半导体硅材料行业多年，始终紧跟市场方向和客户需求，积极把握行业机遇，全方位提升技术、管理、质量和服务水平，加速市场开拓，持续扩大业务覆盖面，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。（5）高效的成本优化。公司不断提升技术研发能力，保证产品质量，在降低产品的生产成本、提高生产效率、增强产品盈利能力方面发挥着重要的作用。谢谢。</p> <p><b>8、公司人才管理方面有哪些重要举措？</b></p> <p>您好！公司作为高新技术企业，所属行业属于技术密集型，对人才要求较高，为进一步推动企业人才结构的提升，提升企业的竞争力与创新能力，一方面，公司不断完善人才体系建设，坚持通过对内人才自主培育与对外引进行业高端人才、专业技术人才相结合的方式，为公司战略规划实现提供充足的人才储备，更好为社会创造价值。另一方面，公司已建立较为完善的薪酬福利制度和企业文化，通过实施股票激励计划，吸引和留住优秀人才，同时，公司持续实施人才引进计划，优化关键人才供给保障机制，强化人才培养标准化体系管理，重点跟进高管、中层干部等关键岗位人才梯队建设以保障公司未来发展的需求。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 10 日